公司代码：688498　　公司简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本85,947,726股，扣除目前回购专户的股份余额452,149股后参与分配股数共85,495,577股，以此计算合计拟派发现金红利8,549,557.70元（含税）。

如在报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上利润分配方案经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	源杰科技	688498	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程硕	吴晶
联系地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
电话	029-38011198	029-38011198
传真	029-38011198	029-38011198
电子信箱	ir@yj-semitech.com	ir@yj-semitech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为光芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G、200G以及更高速率的DFB、EML激光器系列产品和50mW、70mW、100mW、150mW等大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域，公司产品涵盖1550波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。

通过持续的研发投入构建差异化竞争优势，公司从电信市场收入为主的光芯片供应商，逐步发展国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

应用领域			速率	产品类型
电信市场类	移动通信网络	光纤接入EPON	2.5G	1310nm FP
		光纤接入GPON	2.5G	1310nm DFB
			2.5G	1490nm DFB
		光纤接入10G PON	2.5G	1270nm DFB
			10G	1270nm DFB
			10G	1577nm DFB
			10G	1577nm EML
			10G	1577nm w/SOA
		光纤接入25G/50G PON	25G	1300nm DFB
			25G	1286nm DFB
			25G	1358nm EML & 1358nm w/SOA EML
			50G	1286/1342nm EML & 1286/1342nm w/SOA EML
		4G移动通信网络	10G	1310nm FP
			10G	1310nm DFB
			10G	1310nm AntireflectionDFB
			10G	1270～1570nm CWDM16 DFB
		5G移动通信网络	25G	1310nm FP
			25G	10G overclock 1270～1370nm CWDM6 DFB
			25G	1270/1330nm DFB
			25G	1310nm DFB
			25G	1270～1370nm CWDM6 DFB
			25G	LWDM12 Channel DFB
			25G	MWDM12 Channel DFB
			50G	1270～1370nm CWDM6 DFB
	数据中心类	数据中心	10G	1270～1330nm CWDM4 DFB
			25G	1270～1330nm CWDM4 DFB
			25G	LWDM4 Channel DFB
			50G	1270～1330nm CWDM4 PAM4 DFB
			100G	1270～1330nm CWDM4 PAM4 EML
			100G	1304/1307/1309/1311nm Narrow LWDM PAM4 EML
			200G	1270～1330 CWDM4 PAM4 Single & Differential Drive EML
			CW	100mW 1310nm CW DFB
			CW	100mW CWDM4 CW DFB
			CW	70mW CWDM4/8 CW DFB
			CW	70mW 1310nm CW DFB
			CW	70Mw LWDM4 CW DFB
			CW	50mW 1310nm CW DFB
			CW	25mW CWDM4 CW DFB
			CW	150mW 1310nm CW DFB
车载激光雷达及传感			/	1550nm Pulse DFB
			/	CH4 sensor

注：

1、2.5G、10G、25G、50G、100G、200G代表激光器芯片的传输速率；CWDM、LWDM、MWDM代表可应用于波分复用网络的激光器芯片；PAM4代表可应用于PAM4脉冲调制技术的激光器芯片；

2、报告期内，公司主要向客户销售激光器芯片，但为满足部分客户需求，公司会将激光器芯片封装后进行销售。

2.2 主要经营模式

1、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，设立市场与销售部负责开发客户、产品推广以及维护客户关系。市场与销售部根据客户需求情况制定销售计划，将接收到的订单需求反馈给生产与运营部，协调产品研发、生产、交付、质量等服务工作，同时承担跟单、售后、技术支持等工作。

新产品及客户导入方面，由于光芯片产品设计参数、性能指标多，公司市场与销售部根据客户需求先与其进行深度技术交流，研发部在此基础上进行产品设计、材料选型、样品生产等工作，然后在厂内进行样品性能测试、可靠性测试，并将样品送至客户处进行综合测试。测试通过后，客户会小批量下单采购，并在多批次生产合格后，转入批量采购。公司的成熟产品主要通过展会、现有客户推荐、销售经理开发等方式寻求新客户。

2、采购模式

每月月底采购部根据生产与运营部提供的次月生产计划及安全库存，制定对应的生产原物料采购计划（包括预测需求），采购员根据采购计划向合格供应商下达PO（采购订单），明确技术规格、交货周期及条款。建立VMI（供应商管理库存）机制保障关键物料供应。IQC部门依据AQL（可接受质量水平）标准执行进料检验，采用SPC（统计过程控制）方法监控关键质量特性，出具COA（检验分析报告）作为放行依据。由仓管科负责核对到货单物料数量与采购订单物料数量，财务部负责最终付款。另外研发部门、生产类部门、厂务部门、行政部门等根据公司经营需要，制定相应各部门采购计划并提前传递采购部审核，由采购部统一采购。

公司制定供应商认证及供应商管理流程，对新的供应商进行资质评估及调查，对提供的样品进行验证，并进行合格供应商评审，合格的供应商将被录入《合格供方名单》。公司对供应商进行绩效考核并分级管理，按需进行物料替代管理、供应商稽核管理，确保公司的采购质量符合ISO9001/14001体系要求，确保采购活动满足QCDS（质量/成本/交付/服务）综合目标。

3、生产模式

公司生产激光器芯片属于IDM模式，掌握芯片设计、晶圆外延等光芯片制造的核心技术，拥有覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试等自主生产的能力，公司的IDM模式能够缩短产品开发周期，实现光芯片制造的自主可控，快速响应客户并高效提供相应解决方案，能够迅速地应对动态市场需求。

公司生产以市场需求为导向，生产与运营部根据客户订单协调相关部门制定生产计划。公司根据年度销售策略进行产能评估，提前适当备货以应对需求高峰，保持库存的适度水平，减轻生产压力。

4、研发模式

公司研发以行业发展、应用需求及研发项目为基础，新产品研发流程以研发部《设计和开发控制程序》体系进行管理，从立项开始先后经历6个阶段，主要包括：立项、设计输入输出、工程验证测试（EVT）、设计验证测试（DVT）、研发转生产培训考核、批量过程验证测试优化（PVT）等阶段，各阶段要求满足后进入下一阶段，具体如下：

（1）立项阶段

市场与销售部根据客户及市场需求，提出新项目立项申请，填写《项目研发建议书》，并提交市场与销售部、研发部及总经理共同评审。项目评审通过后，指定项目负责人制作项目可行性分析，包括项目方案概况列举、项目预算、研发过程风险预估与对应措施，确定参与人员、明确客户指标需求等。

（2）设计输入输出阶段

项目负责人根据立项阶段资料，制作设计开发阶段指导文件及流程，包括产品技术参数、工艺指导文件、结构设计、工艺流程设计、环保分析、研发过程失效分析及对应的控制措施等。

（3）工程验证测试阶段（EVT）

研发部根据《设计和开发控制程序》要求进行投片，参照设计输入输出阶段工艺指导文件与流程进行样品试制，在试制结束后对客户需求指标进行测试分析。此阶段针对产品特性与工艺生产异常关闭率进行评审。第一轮样品试制若无法满足客户需求，研发项目团队总结样品试制过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，获得批准后进行下轮样品试制，直到满足客户需求后可转入下一阶段。

（4）设计验证测试阶段（DVT）

研发部根据投片数量进行设计验证测试，对客户需求指标进行测试并分析。此阶段针对产品稳定性与异常关闭率进行评审。设计验证测试结束若无法满足客户需求，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，从上一阶段的工程验证测试（EVT）开始开发，直到满足客户需求并通过验证。

（5）研发转生产培训考核阶段

研发转生产培训考核阶段，研发部提供给生产与运营部相关资料，包括输出工艺标准指导书、工单、参数对照表、质检标准、标准工时统计表、试生产任务单等，并根据需求对生产线相应的人员进行培训与考核，通过评审后方可转入下个阶段。

（6）批量过程验证测试优化阶段（PVT）

批量过程验证测试优化阶段（PVT），生产与运营部接收研发转生产阶段文件后，评估产线产能、管理投入设备并分析人员、安全和环境等因素，确认具备量产能力后，制定并组织实施生产计划，投入资源进行批量验证与测试。在批量生产过程中，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，直到达到预期目标并通过验证。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段及基本特点

随着全球信息互联规模不断扩大，人工智能等技术的兴起，光电信息技术正在被进一步广泛应用。在这种趋势下，光芯片的下游应用场景不断扩展，需求量不断增加，同时对光芯片的速率、功率、传输距离也提出更高的要求。目前在电信市场、数据中心市场，光芯片都得到了较为广泛的应用，其中电信市场又可以细分为光纤接入和移动通信两个细分领域。

电信市场：2024年，5G、千兆光纤网络等新型基础设施建设进一步完善。在光纤接入市场：截至2024年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户，全年净增3,352万户。其中，1000Mbps及以上接入速率的用户为2.07亿户，全年净增4,355万户，占总用户数的30.9%，占比较上年末提高5.2个百分点。固定互联网宽带接入端口数达到12.02亿个，比上年末净增6,612万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到11.6亿个，比上年末净增6,570万个，占比由上年末的96.3%提升至96.5%。截至2024年底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2,820万个，比上年末净增518.3万个。在无线通信领域，5G网络建设深度覆盖。截至2024年底，全国移动电话基站总数达1,265万个，比上年末净增102.6万个。5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。随着无线和光纤接入部署逐步进入成熟期，下一代技术逐步开始布局。光纤接入领域开始向“万兆”加速。作为ITU-T定义的下一代PON技术，50G PON比10G PON带宽提升了5倍、时延降低了100倍，具备提供确定性业务体验的能力。根据工信部《关于开展万兆光网试点工作的通知》的内容，到2025年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。以试点工作为牵引，推动产业链各方加快协同解决目前万兆光网落地应用中的重点难点问题，带动我国万兆光网核心技术和关键设备取得突破，促进构建万兆光网成熟产业链和完备产业体系，有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用。同时，由于5G-A在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升，引入了通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术，能更好地匹配人联、物联、车联、高端制造、感知等场景。运营商也逐步推进其商用部署或组网试点。相关技术的成熟与推广，有望对相关的产业链形成拉动作用。

数据中心市场：随着人工智能的快速发展，模型性能提高，需要大量算力，导致对光器件的需求、能力的增加。在这样的背景下，数据中心市场高速率需求持续增加。2024年，国内外CSP对AI基础设施的投资推动400G/800G以太网光模块出货量激增，进而拉动光芯片的需求。这一投资趋势在2025年持续加强，同时中国云厂商也开始进一步的跟进。在速率方面，2025年1.6T光模块将开始批量出货。随着交互速率及训练集群规模的提升，业界对功耗、散热、成本提出了更高要求，因此系统互联互通的方式需要不断优化，以实现更高的能效比和更紧凑的封装设计。低功耗、小型化、集成化将成为未来光模块发展的重要趋势。目前，硅光技术在可插拔光模块中逐步提升，特别在高速率模块中应用渗透率进一步加大。LPO方案也是未来趋势，其在特定场景中表现出较低功耗和成本的优势。进一步来看，未来CPO、OIO的发展和应用，也将带来更多光互联领域的新增量。Light Counting在最新报告中指出，光通信芯片组市场预计将在2025至2030年间以17%的年复合增长率（CAGR）增长，总销售额将从2024年的约35亿美元增至2030年的超110亿美元。

(2)主要技术门槛

更高速率、更高功率、更长传输距离的光芯片的技术研发、工艺设计具有更高开发难度与门槛。一方面，随着需求提升，光芯片的结构设计的精度要求极高，技术研发及工艺开发需结合高速射频电路与电子学、微波导光学、半导体量子力学、半导体材料学等多学科，设计合适的芯片结构，满足芯片精度及尺寸的要求；另一方面，激光器芯片的生产需要几十至几百道工序，每道生产工序都将影响产品最终的性能和可靠性，因此对生产线工艺成熟和稳定有极高要求。此外，高速率激光器芯片相较于中低速率产品，在量子阱有源区、光栅层结构区、模斑转化器区域、光波导结构区、电流限制结构区、高频电极结构、谐振腔反射膜等关键结构的设计与开发上，需综合考虑光电特性、产品可靠性、制备工艺可行性等相互制约因素，因此存在极高壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。

在电信市场中，目前所需的2.5G、10G激光器芯片市场国产化程度较高，但不同波段产品应用场景不同，工艺难度差异大，公司凭借长期技术积累实现激光器光源发散角更小、抗反射光能力更强等差异化特性，为光模块厂商提供全波段、多品类产品，同时提供更低成本的集成方案，实现差异化竞争；未来25G/50G PON接入网对光芯片的要求也将进一步提升，大功率、低色散、高速调制的场景需求提升了光芯片的技术门槛，公司已开发相应的集成技术与光放大器集成技术平台，适配高速接入网的需求，使公司的PON光芯片产品具备更强的市场竞争力，进入下一代高速需求的迭代过程。

在数据中心市场中，尤其是以人工智能为代表的应用拉动了400G、800G或以上高速光模块的需求增加，进而带动了高速率、大功率的芯片需求，比如主要为100G PAM4 EML光芯片、70mW、100mW大光功率激光器等。目前数据中心市场仍以海外供应商为主。公司基于多年在光芯片领域的研发和生产积累，已推出相应的高速EML、大功率激光器产品，无论是单波或是多波长的CWDM、LWDM需求，来适配相关的高速光模块的需求，且性能及可靠性等指标可对标海外同类型产品。目前，公司在AI数据中心市场实现销售突破。尤其是硅光模块解决方案所需的全系列大功率CW激光器产品，2024年面向400G/800G硅光模块的CW芯片产品已实现百万颗以上出货，奠定了公司在该领域较为领先的行业地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）硅光技术逐渐成为提升成本效率重要方案之一

降本、降功耗、增效始终是算力发展过程中不断追求的方向。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。AI的爆发大幅提升了对光模块速率和数量的需求，使得降本降功耗更为紧迫，这导致了客户对硅光的接受度有望提升。目前，硅光方案的光模块在400G和800G的渗透率有明显的提升，下一代1.6T的光模块中，硅光方案占比将进一步提升。在硅光方案中，CW激光器芯片作为外置光源，硅基芯片承担速率调制功能。CW大功率激光器芯片，要求同时具备大功率、高耦合效率、宽工作温度的性能指标，对激光器芯片要求更高。

（2）关注CPO等新技术的演进

随着单通道速率提升，电链路距离越长损耗越大，需要将光引擎更靠近交换芯片。因此，CPO技术通过将交换芯片和光引擎封装在一起，缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，从而帮助电信号在芯片和引擎之间更快地传输，减少尺寸，提高效率，降低功耗。从目前CPO相关技术路径构架来看，在CPO交换机中CW光源单颗价值量将提升，同时所需要的功率也将进一步提高。

（3）光芯片下游应用市场不断拓展

光芯片的应用领域正在不断拓展。在传感领域，如环境监测、气体检测，光芯片被用作传感器，能够检测光信号并转换为电信号，用于数据采集和分析。在汽车领域，随着传统乘用车的电动化、智能化发展，高级别的辅助驾驶技术逐步普及，核心传感器件激光雷达的应用规模将会增大。基于砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）的光芯片作为激光雷达的核心部件，其未来的市场需求将会不断增加。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,147,544,868.83	2,236,682,340.61	-3.99	2,295,683,768.92
归属于上市公司股东的净资产	2,072,766,453.62	2,116,687,842.73	-2.08	2,102,471,916.64
营业收入	252,172,673.21	144,403,649.04	74.63	282,905,278.42
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	252,104,151.44	144,045,936.03	75.02	282,847,024.38
归属于上市公司股东的净利润	-6,133,875.94	19,479,815.27	-131.49	100,316,964.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,426,044.66	-238,669.33		91,866,664.92
经营活动产生的现金流量净额	18,960,995.49	-17,399,733.48	不适用	37,739,184.13
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	0.92	减少1.21个百分点	14.99
基本每股收益(元／股)	-0.07	0.27	-125.93	2.23
稀释每股收益(元／股)	-0.07	0.27	-125.93	2.23
研发投入占营业收入的比例(%)	21.62	21.43	增加0.19个百分点	9.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	60,063,175.77	60,095,690.92	58,018,943.68	73,994,862.84
归属于上市公司股东的净利润	10,534,967.18	216,324.83	-11,301,423.15	-5,583,744.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,570,094.24	-99,849.95	-13,823,807.50	-7,072,481.45
经营活动产生的现金流量净额	22,407,486.05	-9,560,251.70	-21,693,914.15	27,807,675.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,540
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
ZHANG XINGANG	-	10,562,958	12.36	10,562,958	无	-	境外自然人
秦燕生	-	4,604,859	5.39	4,604,859	无	-	境内自然人
秦卫星	-	4,478,859	5.24	4,478,859	无	-	境内自然人
苏州瑞璞股权投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	-836,359	3,389,618	3.97	-	无	-	其他
张欣颖	-	2,944,053	3.44	2,944,053	无	-	境内自然人
陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）-陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	-	2,367,225	2.77	-	无	-	其他
全国社保基金六零二组合	未知	1,671,217	1.96	-	无	-	其他
国投创业投资管理有限公司-国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-561,104	1,644,652	1.92	-	无	-	其他
杭州汉京西成创业投资合伙企业（有限合伙）	-2,681,396	1,495,000	1.75	-	无	-	境内非国有法人
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,081,072	1,282,863	1.50		无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、ZHANG XINGANG和张欣颖系兄妹关系；2、秦燕生和秦卫星系兄弟关系；3、ZHANG XINGANG与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人；4、ZHANG XINGANG与欣芯聚源为一致行动人；5、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

存托凭证持有人情况

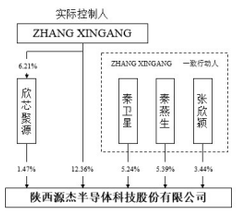
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入25,217.27万元，同比增加74.63%；归属于母公司所有者的净利润-613.39万元，同比下降131.49%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,142.60万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2025-026

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月14日召开第二届董事会独立董事专门委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并将该事项提交董事会审议。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，非关联董事和监事一致审议通过本次关联交易预计的事项。该事项无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计情况

结合公司业务发展及生产经营情况，公司对2025年度日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬）额度进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	115.00	100	61.08	103.67	100	不适用
	小计	115.00	/	61.08	103.67	/	/

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年度公司日常关联交易的预计和实际执行情况（不包括关键管理人员薪酬）如下，实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受市场及客户需求变动等因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	苏州旭创科技有限公司、成都智禾光通科技有限公司(曾用名:成都旭创科技有限公司)	46.03	46.03	不适用
接受关联人劳务	西安顺丰速运有限公司	6.67	6.67	不适用
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	110.00	103.67	不适用
小计		162.70	156.37	

注：在2023年3月10日前，宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波创泽云”）为公司持股5%以上的股东，苏州旭创科技有限公司（简称“苏州旭创”）为宁波创泽云的主要出资人，成都智禾光通科技有限公司（简称“智禾光通”，曾用名：成都旭创科技有限公司）为苏州旭创的全资子公司。西安顺丰速运有限公司（简称“顺丰速运”）的董事（副董事长）林哲莹通过控制宁波创泽云间接持有公司5%以上股份。

2023年3月10日，因期权激励计划行权，公司总股本由6,000万股变为6,059.90万股，宁波创泽云持股比例被动稀释至5%以下。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。2024年3月10日前，公司仍将同上述三个主体的交易事项作为关联交易进行审议和披露。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、咸阳华汉光电密封制品有限公司

咸阳华汉光电密封制品有限公司成立于2011年9月20日，法定代表人秦卫星，注册资本200万元人民币，注册地址位于陕西省咸阳市秦都区渭滨街道西里路北段3号。其经营范围为一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	咸阳华汉光电密封制品有限公司	咸阳华汉光电密封制品有限公司为公司董事及股东秦卫星、股东秦燕生共同控制的企业。截至2024年12月31日，秦卫星持股比例为5.24%，秦燕生持股比例为5.39%。

（三）关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为接受关联人租赁。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2025-027

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资金使用效率，公司及全资子公司、孙公司2025年度拟向招商银行咸阳分行、中信银行西安分行分别申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，向汇丰银行西安分行申请不超过3,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授信总额度不超过1.3亿元人民币（含等值外币），授信额度期限为自董事会审议批准之日起12个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、流动资金贷款、信用证等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信期和授信额度内，提请授权公司董事长代表公司签署一切综合授信相关的法律文件，提请授权公司财务负责人协助公司具体落实上述综合授信的相关手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2025-029

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及内容

2024年，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（《企业会计准则解释第18号》），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）会计政策变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

本次会计政策变更事项自2024年1月1日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	采用变更后会计政策增加/减少报表项目金额	
	2024年	2023年
营业成本	-251.69	-184.01
销售费用	251.69	184.01

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合